



同方国芯电子股份有限公司

业务介绍

2013.4



一、公司简介

- 公司原名“唐山晶源裕丰电子股份有限公司”，成立于1990年，2005年6月在深圳证券交易所上市，证券简称为“晶源电子”。
- 2012年7月更名为“同方国芯电子股份有限公司”，证券简称为“同方国芯”，证券代码为002049。
- 公司首次公开发行上市时总股本为75,500,000股，现总股本为303,408,984股。

2013年3月31日股东结构

- 同方股份：41.38%
- 前50股东：85.21%
- 前100股东：88.78%
- 非限售股：30.65%

2012年12月31日股东结构

- 同方股份：42.28%
- 前50股东：84.54%
- 前100股东：88.08%
- 非限售股：31.31%



董事长 陆致成



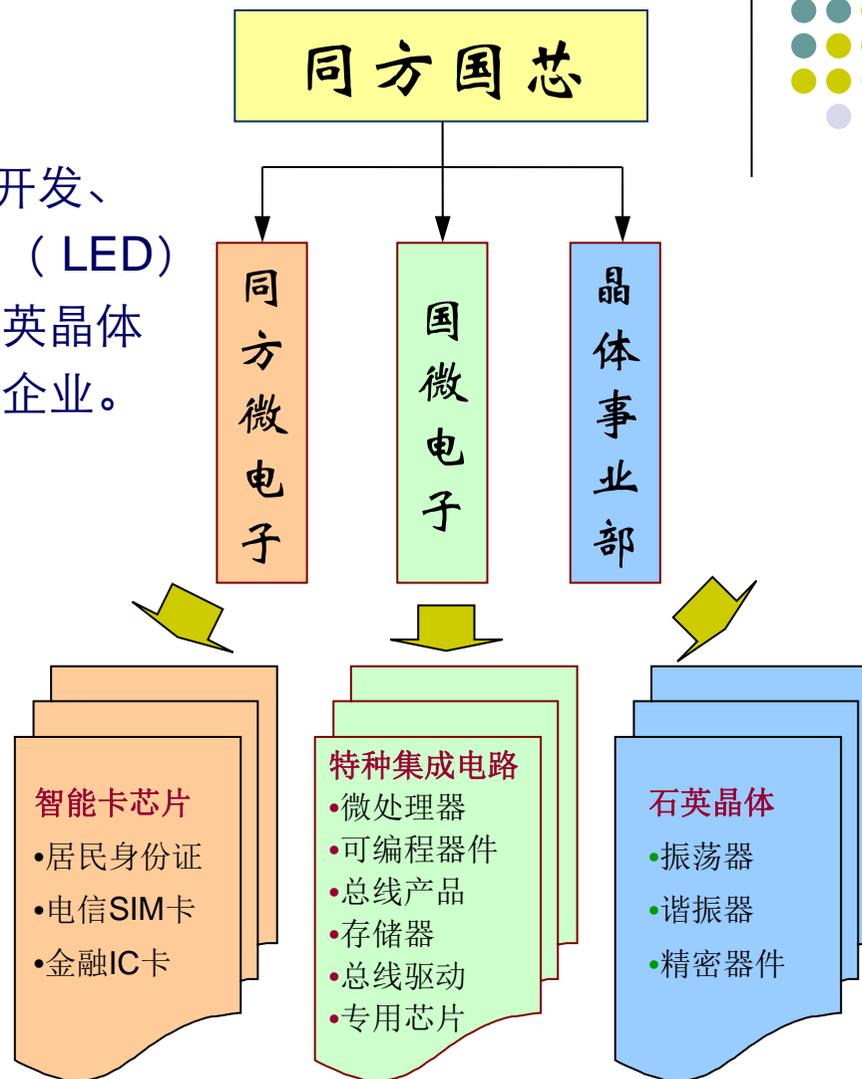
总裁 赵维健



二、公司主要业务

同方国芯是从事集成电路设计、开发、销售与技术服务；高亮度发光二极管（LED）衬底材料开发、生产、销售；压电石英晶体器件的开发、生产和销售的高新技术企业。

公司现已成为集成电路设计专业企业，核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路两部分，分别由全资子公司北京同方微电子和深圳市国微电子有限公司承担。上述两子公司均为国家规划布局内集成电路设计企业、国家高新技术企业。母公司的晶体事业部承担石英晶体业务。





三、近三年主要财务数据

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产	272,515.30	132,964.11	121,300.57
总负债	69,316.89	27,448.91	24,749.32
净资产	203,198.41	105,515.20	96,551.25
归属母公司股东的 所有者权益	198,385.17	104,077.92	95,220.37

2、合并利润表

单位：万元

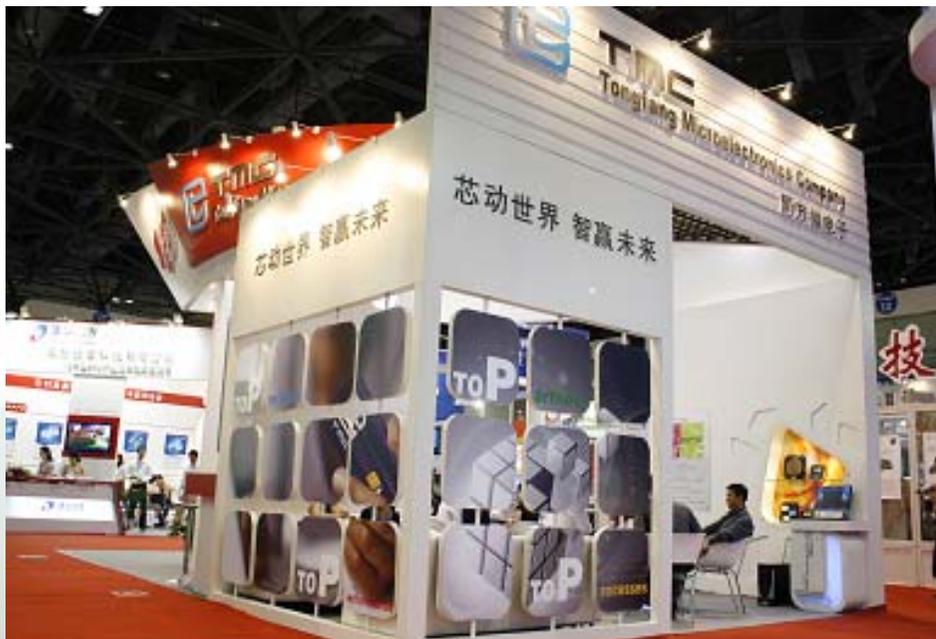
项目	2012年	2011年	2010年
营业收入	58,456.28	62,998.12	53,885.46
利润总额	15,869.20	12,253.25	9,670.54
归属母公司股 东的净利润	14,127.51	10,342.55	7,951.75

※ 表中2010、2011年财务数据为合并同方微电子追溯调整后数据。





- 北京同方微电子有限公司





同方微电子为国内知名的集成电路设计企业，致力于身份识别、电信运营、金融支付、信息安全等领域智能卡的核心芯片开发与销售。公司注册资金1亿元，员工总数150人。

公司为国家高新技术企业、国家规划布局内集成电路设计企业。

● 公司盈利情况

项 目	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
营业收入/万元	(71,688.89)	(62,169.23)	33,231.39	34,229.48	34,428.56
净利润/万元	(12,081.80)	(10,715.20)	12,801.62	7,269.28	7,035.96



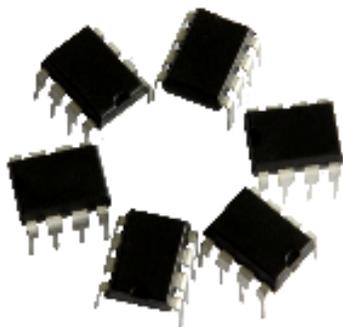
● 公司资产情况

	总资产(亿)	净资产(亿)
2012	9.16	6.52
2011	8.14	5.91
2010	6.94	5.18



目前公司主要产品包括：第二代居民身份证专用芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类芯片（包括公交卡、社保卡、居民健康卡、移动支付卡、金融IC卡等）、USB-key芯片和读写器射频芯片等。近两年，公司主要产品情况如下：

- 电信SIM芯片
- 第二代居民身份证芯片
- 金融支付类芯片
- UKey芯片
- 读写器射频芯片



分类	产品	2012年		2011年	
		收入(元)	毛利率	收入(元)	毛利率
电信类	SIM卡	131,649,925.12	5.72%	154,727,047.72	7.22%
非电信类	身份识别 金融支付	200,663,966.54	58.46%	187,567,769.71	57.31%
合计		332,313,891.66	37.56%	342,294,817.43	34.67%



● 二代身份证芯片

■ 中国的第二代居民身份证项目是目前全球最大的非接触CPU卡项目。截止到2012年底，二代身份证已经出货超过13亿，同方微电子出货达3.5亿张。

■ 由于2013年起第一代居民身份证已停止使用，2012年的第二代身份证芯片采购量有小量增长。目前，同方微电子的身份证芯片生产稳定，供货顺利，库存正常。

■ 2014年起，由于十年期的二代身份证开始到期换发，因此会有一个持续4-5年的发行小高峰期。



● 电信SIM卡芯片

- 行业情况：全球SIM年出货量40亿，
- 同方微电子占全球市场近10%的份额。全球前6大智能卡商中的5家都是同方微电子的大客户。

- 同方微电子出货快速增长，2011年出货3.5亿只，2012年出货4.4亿只，2013年预计6.5亿只。

- 新工艺平台为同方微电子提供强大竞争力：
 - Shrink-cell技术，增强成本优势；
 - Flash工艺线上独家合作伙伴；
 - 公司获授权开发flash block，进一步增强竞争力

- 核高基项目大容量SIM卡提供新的增长点，应用于移动的高端用户。案例有吉林移动VIP专属卡。





● 银行卡芯片

■ 人民银行颁布64号文件，标志我国银行卡产业在全国范围内启动从磁条卡向IC卡的迁移工作。要求：

- 2015年起，发达地区、重点合作行业领域，商业银行新发银行卡应为PBOC卡
- 2013年起，全国性商业银行开始发PBOC卡
- 2011年7月起，中行等四大行、交、招、邮政应开始发PBOC卡
- 地方性商业银行根据实际情况，发行PBOC卡



■ 总体情况

- 国内银行磁条卡保有量近30亿张，目前，银行IC卡发卡量近亿张。
- 现有的银行卡芯片全部是国外芯片，检测标准也来自国外。考虑到整体金融环境的稳定和产业升级的需要，国内政策倾向于国密算法，国产芯片，自主检测。

■ 同方微电子

- 双界面java卡产品的储备处于国内第一的位置，配置丰富；
- 已在银检中心通过了双界面卡的备案检测，2013年能有小批量试用。



● 社保卡芯片

■2011年8月，人力资源和社会保障部与央行共同发布，力争用5年左右时间基本实现社保卡普遍具有金融功能的目标。加载金融功能以后，社保卡可作为银行借记卡在境内使用。

■截止2012年，社保卡累计发行约3亿张。按规划，至2015年，金融社保卡的持卡人要达到8亿。

■由于金融社保卡规范刚刚发布，各家芯片商都在进行入围测试。

■同方微电子于2012年7月完成了社保资质入围的芯片备案工作，11月完成了相关COS的测试工作。近期中标两个省级应用。





● 居民健康卡芯片

■居民健康卡是在医疗卫生服务活动中用于身份识别，满足健康信息存储，实现跨地区和跨机构就医、数据交换和费用结算的卡片，居民人手一张。

■居民健康卡已经提升至民生工程，是一个新兴的市场，各厂商陆续进入。同方微电子已经准备多年，具有领先优势。

■同方微电子参与前期的各种标准讨论，为规范标准提供了坚实的理论支持。

■在卫生部统计信息中心搭建居民健康卡演示平台的过程中，同方微电子独家提供了演示系统平台中居民健康卡用户卡芯片和SAM卡芯片。

■同方微电子提供最为全面的方案选择，在产品储备和方案完备性上远远走在竞争对手前面：

- 单纯的卫生应用单芯片方案
- 卫生加银行功能一卡双芯方案
- 卫生加载银行功能一芯多用方案

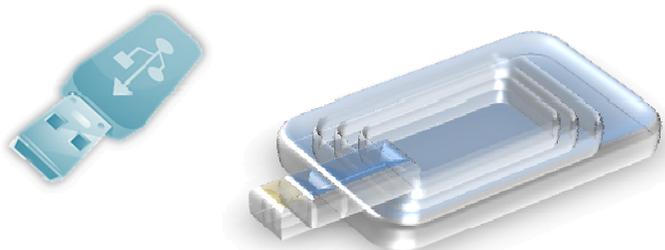
■目前的试点区域中，同方微电子覆盖了50%左右。





● USBKEY和支付终端

- 各商业银行均在大力发展网上银行用户，USBKEY作为网上银行交易的身份凭证，每年需求量在9000万以上。
- 随着USBKEY广泛使用，其安全形势面临很大挑战，带显示按键的二代KEY成为市场主流。
- 第三代USBKEY的应用已经提上日程，即通常所说的互联网支付终端。该类支付终端，不仅具有二代KEY的功能，还相当于一个小型POS机。随着EMV的迁移，银行卡的大量发行，互联网支付终端将改变人民的线上消费模式。



	同方微电子产品竞争力
二代key产品	2012年底推出，使用130nm工艺，具有强大的成本优势，还包含了动态令牌功能，预计2013年占据国内10%市场份额。
三代key产品，即互联网支付终端产品	2013年Q2推出，极具成本优势；与银行卡同样安全等级；集成非接触读卡功能，满足EVM level 1的需求



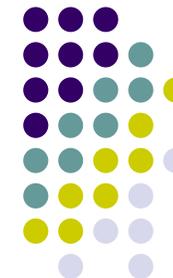
● 移动支付

- 手机支付产品众多，各种手机支付方案争相亮相，如NFC、SIMpass、2.4G RF-SIM、ISIM等等，但尚未形成主流的完善的解决方案。

	市场容量	同方微电子竞争力
SWP-SIM	全球SWP-SIM市场正在全面启动，国内运营商也频繁试点，尤其中国移动已经积极推动卡商进行开发测试。SWP-SIM目前主要是国外芯片商在提供。	同方微电子在SWP-SIM上已经有积累产品，并且以SWP-SD的形式量产出货过，合作方为银联。2013年Q1，会推出和银行卡产品相同安全等级的SWP-SIM产品。
13.56双界面SIM	作为过渡方案，2012年国内采购数量预计在800万~1000万，预计2013年将会有小幅增长或平稳。	同方微电子是国内首家提供大容量双界面SIM产品的厂商，2012年出货量预计100万左右，2013年出货预计有大幅增长。其利润较高。
13.56全卡	全卡方案正处于技术储备阶段，一旦技术成熟将带来爆发式增长	同方微电子已经投入专家团队来介入全卡方案的产品开发，预计到2013年中，将有样品面世

深圳市国微电子有限公司





公司概况

- 主营业务：从事集成电路设计、开发与销售。具有全部特种集成电路行业所需资质。公司是国内特种元器件行业龙头企业，是国内特种元器件行业门类最多、品种最全的企业。
- 公司完成了近**200**项产品，科研投入总经费**9**亿余元；其中“核高基”重大专项支持经费**3**亿多元。
- 目前公司员工约 **360**人，在成都有一全资子公司，在北京、上海、西安、成都等地设有办事处。

国微电子定位：做国内最大的特种集成电路供应商



近三年主要财务数据

项 目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31
总资产	42,894.67	41,042.43	19,149.51
总负债	27,867.52	29,985.83	13,376.84
净资产	15,027.15	11,056.60	5,772.68

项 目	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年
营业收入	(32,430.92)	(25,914.04)	19,281.21	15,762.13	9,826.55
归属母公司股东的净利润	(11,533.20)	(8,600.36)	8,350.19	3,980.22	1,744.69

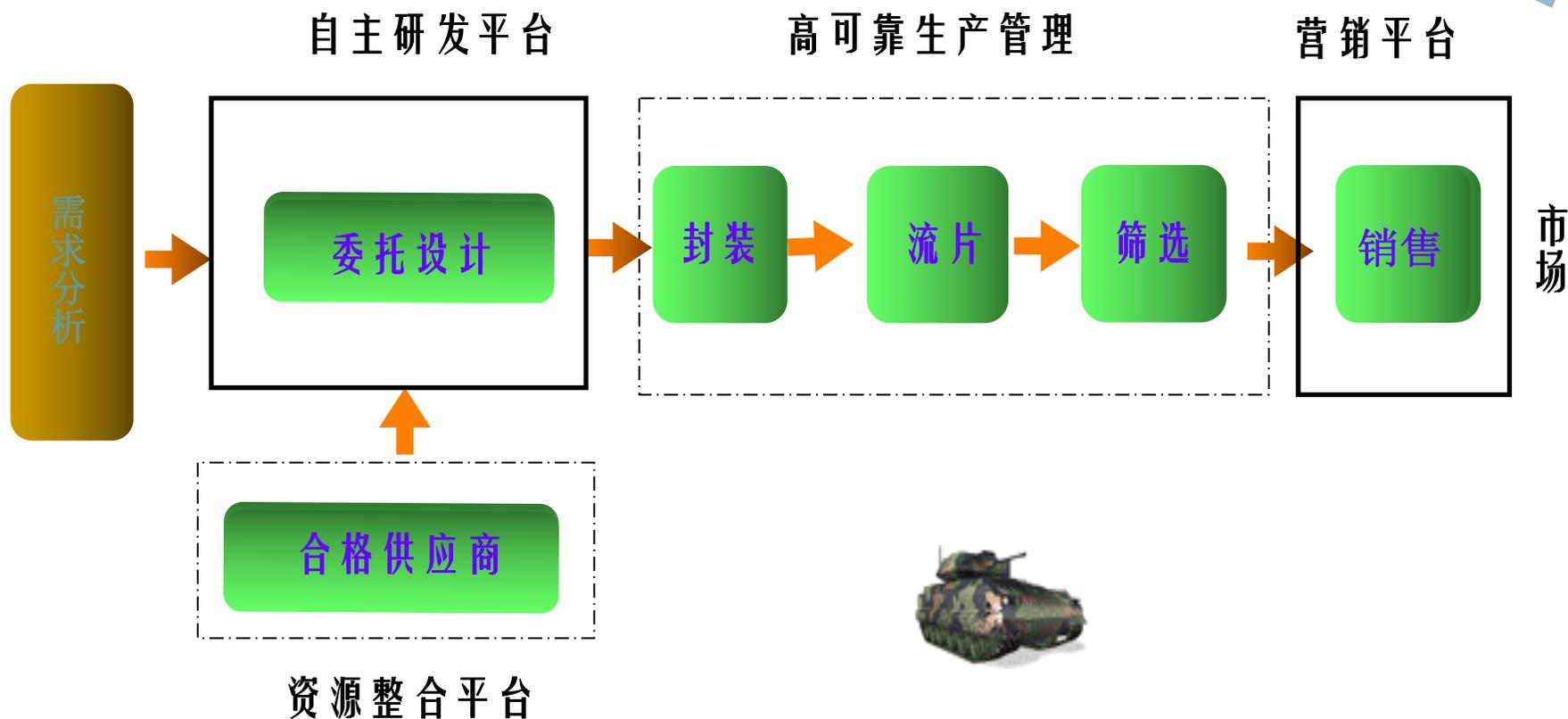
※ 合并利润表中2013-2014年数据为预测数。





商业模式

企业申请，政府委托，企业自主生产销售





主要业务

产品系列

- ◆ 微处理器
- ◆ 可编程器件
- ◆ 总线产品
- ◆ 存储器
- ◆ 总线接口、驱动类产品
- ◆ 专用芯片（**ASIC/SOC**）产品



市场分析

- ✓ 特种集成电路市场：近年年均增长超过10%，增长潜力大
- ✓ 产业政策：由重进口----强制国产化
 - 2010、2011年国家出台法规 → 自主可控
 - 当前国产化率 → 2020年国产化率
- ✓ 信息化占装备比例：不断提升
 - 2010年西方武器装备信息化比例的平均值将超过50%，中国约为20%
 - 电子元器件占信息化比例约50%

集成电路市场规模将不断提升



竞争力分析

- ✓ 进入门槛高
- ✓ 和同行比，产品种类最全，品种最多
 - 目前可销售产品达到100多种
 - 许多还在试验试用阶段



- ✓ 国微电子在研项目转化产品能力强
 - 在研项目超过50项
 - 年均新增产品近30项
- ✓ 市场化程度高，市场竞争能力强
 - 灵活的体制机制
 - 快速的市场反应能力
 - 一批战略合作伙伴



应用领域

- 航空
- 航天
- 电子
- 船舶

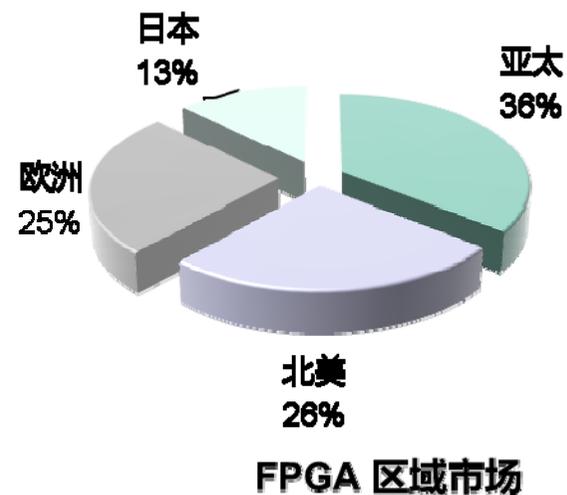




发展规划（1）--FPGA产品

1. 市场规模

- ✓ 2012年全球市场48亿美元
- ✓ 2012年中国市场规模32亿美元
- ✓ 2006—2012年增长率：10.8%
- ✓ 寻求FPGA产品市场的突破



2、SSMEC优势

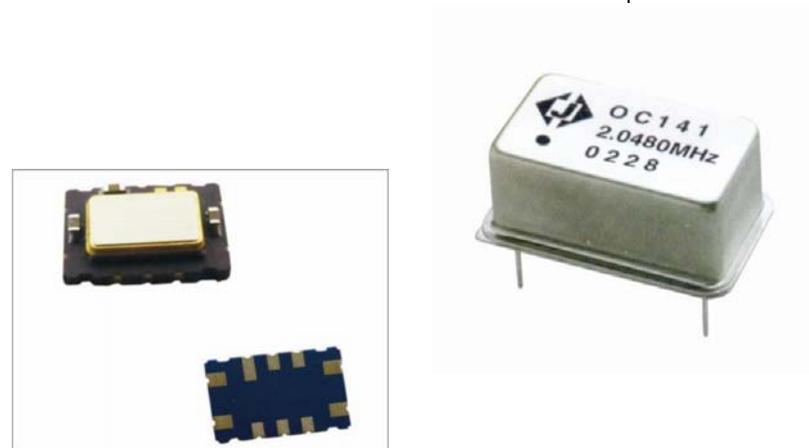
- ✓技术国内领先，依托重大专项，是国内唯一一家提供完全自主研发的百万门级FPGA及其配套开发软件的供应商
- ✓国内军品市场规模约为10亿元人民币
- ✓目前产品现状：从5万门---600万门共十多款产品
- ✓深圳市在国微成立了深圳FPGA重点实验室



发展规划（2）

- 现有产品的系列化、模块化
- 拓展新的产品门类/领域
光电、微波等

● 石英晶体事业部





1、石英晶体业务情况

公司石英晶体业务主要为压电石英晶体元器件的开发、生产和销售。产品包括谐振器和振荡器两大类，目前谐振器占营业收入的80%以上，振荡器的比重在逐年增加。近三年，公司石英晶体业务收入及盈利情况如下：

单位：万元

项目	2012年度		2011年度		2010年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
谐振器	16,751.86	81.35%	19,631.16	80.71%	24,935.33	84.35%
振荡器	3,839.51	18.65%	4,693.03	19.29%	4,626.28	15.65%
合计	20,591.37	100.00%	24,324.19	100.00%	29,561.61	100.00%



项目	2012年度		2011年度		2010年度	
	毛利占比	毛利率	毛利占比	毛利率	毛利占比	毛利率
谐振器	66.43%	11.90%	73.32%	19.68%	78.75%	25.60%
振荡器	33.57%	26.25%	26.68%	29.96%	21.25%	37.24%
合计	100.00%	14.58%	100.00%	21.66%	100.00%	27.43%

- 公司正在开发高精度的温补石英振荡器产品及相关IC芯片。



2、蓝宝石衬底业务情况

公司新投资建设的LED蓝宝石衬底项目总投资 1.14亿元。

- 月产12万片2”衬底晶片加工生产线已经完成设备调试及试生产。产品性能已满足高亮度LED衬底材料和蓝宝石窗口材料等应用的要求。市场开拓工作正在推进中。
- 公司已经完成俄罗斯蓝宝石单晶生产技术和配套设备的引进及安装调试，正在试生产中。





谢谢!

联系电话：0315-6198181

电子邮箱：zhengquan@jingyuan.com

互动平台：<http://irm.p5w.net/ssgs/S002049/>